候補パルスパタンへの対応 要請に対する回答

2018.6.28

ARIB 無線LANシステム開発部会

回答の要旨

ご提案された新パルスパタンに関して以下のように、回答します。

【回答】

- 主要チップベンダは、「新パルスパタンが日本で制度化されるのであれば対応させたい」というスタンスです
- ▶ 机上検討では、技術的には対応可能な見込みです(調査中のベンダ1社、 unsure1社)
- 一方で、回答のあったほぼ全てのベンダが実機での確認が必要という見解を示しています
- 以上のことから、制度化には実際の影響について実機で確認するプロセスが必要となります

なお、対応に必要となるコストは未検討です。製品価格の上昇を最小限に留められるかは、別途調査いたします。また、本制度化の必要性の明確化は引き続きお願いいたします。

(参考)各社での調査結果

- A社の調査結果
 - ∘ 技術的には対応可能
 - 。 実機での動作確認が必要
- B社の3チップベンダへの調査結果は以下となります
 - 記述基準が変わる場合、新レーダーパタンに対応させたいか?(Y: 3社)
 - 各チップベンダの開発環境は、新たなDFS基準について、HW+SWで対応可能か?(Y: 1社 N:0社)
 - ・ 実機テストを行う場合は参加するか?(Y: 2社 N:0社)
 - 各社からのコメント: need individual test for side effects
- ▶ 他の2社の回答
 - チップベンダ X: 社内で確認中
 - セットベンダ Y: 机上検討では技術的には可能。実際の影響の実機での確認、制度の移行方法は別途検討が必要